

IE-PCB-SPM-P-90-THR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SPElink®

**PCB-honor, Single-pair-Ethernet**

Single Pair Ethernet är en teknik som endast kräver ett kabelpar för att överföra data och ström.

Fördelarna med detta gör SPE till det bästa valet av nätverk på fältet och generellt.

Fördelar med Single Pair Ethernet:

- Konsekvent: SPE möjliggör enhetlig Ethernet-baserad kommunikation från givaren till molnet
- Framtidssäkert: nyckelteknologi för industri 4.0 och IIoT
- Flexibelt: räckvidd på upp till 1000 m och överföringshastigheter på upp till 1 Gbit/sek möjliggör ett brett användningsområde
- Innovativt: lägre vikt, mindre utrymmesbehov och enklare installation

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Chassie kontakt, M8 PCB insats, Lödanslutning, Hankontakt, IP67 med kapsling, THT/THR lödanslutning, 90°, Antal poler: 2
Art.nr.	2795100000
Typ	IE-PCB-SPM-P-90-THR
GTIN (EAN)	4064675119159
Förp.	100 Stück

IE-PCB-SPM-P-90-THR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	31,6 mm	Byggdjup (tum)	1,244 inch
Höjd	14,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,571 inch
Bredd	15,2 mm	Byggbredd (tum)	0,598 inch
Nettovikt	8,14 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...85 °C
-----------------	----------------

Systemspecifikationer

Anslutningstyp	Lödanslutning, Hankontakt	Anslutningsvinkel	90°
Antal poler	2	Effektkategori	T1-B
Kategori	T1-B	Lödprocess	Reflow-lödning, Manuell lödning, Våglödning
Montering på kretskortet	THT/THR lödanslutning	Produktfamilj	Industriellt Ethernet
Skyddsklass	IP67 med kapsling	Stickcykler	≥ 100

Elektriska egenskaper

Isolationshållfasthet	≥ 500 MΩ	Märkspänning	72 V
Märkström	4 A	Spänningstålighet kontakt/kontakt	1000 V DC
Spänningstålighet kontakt/skärm	2250 V DC		

Standarder

Kontaktton Norm	IEC 63171-5
-----------------	-------------

Packaging

VPE-längd	392 mm	VPE-bredd	350 mm
VPE-höjd	75 mm		

Materialdata

Isoleringsmaterial	LCP	Färgkod	Silver, svart
Färgtabell (jämförbar)	RAL 7001, RAL 9011	Isolationshållfasthet	≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Kontaktmaterial	Cu-legering	Kontaktyta	Ni/Au
Drifttemperatur, min.	-40 °C	Drifttemperatur, max	85 °C

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

IE-PCB-SPM-P-90-THR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Nedladdningar

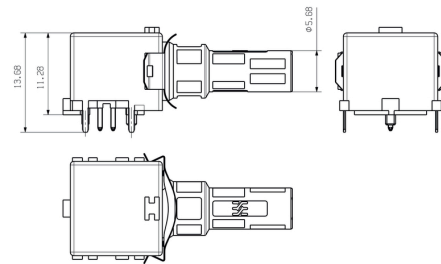
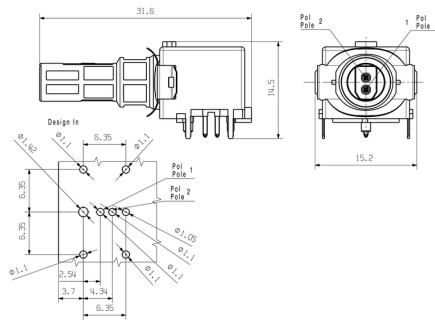
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Teknisk dokumentation	IE-PCB-SPM-P-90-THR
Kataloger	Catalogues in PDF-format

IE-PCB-SPM-P-90-THR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.